

电子行业
2025年11月16日

行业周度点评报告

一中芯国际三季度产品结构、产能利用率改善，毛利率超预期

评级：增持（维持）

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
神工股份	70.38	38.03	119.86
百邦科技	19.27	20.89	24.65
胜利精密	3.78	19.24	128.62
联动科技	104.43	16.45	73.70
奥尼电子	38.48	15.45	44.79

跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
京泉华	28.20	-21.58	76.40
天承科技	71.00	-18.42	88.55
康强电子	17.81	-15.51	66.84
统联精密	51.70	-14.80	83.44
三环集团	44.45	-14.63	851.88

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】周报 20250928 云栖大会看点多，硬件+平台开放助力国产 AI 芯片及模型落地

【金元电子】周报 20251012AMD 与 OPENAI 达成 6GW 协议，开发互连技术 UALink 或加速渗透

【金元电子】周报 20251019 英伟达发布 800VDC 白皮书，“功率墙”应予以重视

【金元电子】周报 20251026 谷歌将量子优势的概念从随机任务推进到可重复验证、具备应用潜力的新阶段

【金元电子】周报 20251109 寒武纪优化基础软件平台，或加速国产算力落地

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

● 行业要闻

- ◆ 中芯国际2025年第三季度营收同比增长，先进工艺推动业绩改善
- ◆ 锐捷业绩不如预期股价回档，市场仍看好AI拉动长期成长趋势
- ◆ 英特尔股价再下挫，OpenAI明确排除采购英特尔晶片引发关注
- ◆ 记忆体缺货加剧，华邦电10月营收写下39个月新高
- ◆ 宜特启动次2奈米 ALD 新材料平台，切入材料端验证关键链路
- ◆ AI高电流与高速传输需求爆发，贝尔威勒将以105元登录兴柜

● 公司动态：

- ◆ 奕东电子：2025年第二次临时股东大会决议公告
- ◆ 海能实业：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
- ◆ 鼎佳精密：2025年第三季度权益分派实施公告
- ◆ 乾照光电：关于公司高级管理人员股份减持计划完成的公告
- ◆ 长光华芯：股东及董事减持股份结果公告

● 投资建议：我们认为，中芯国际 2025Q3 业绩报告释放国内消费电子为代表的模拟 IC、MPU 等成熟制程芯片国产替代放量，叠加汽车电子补库存驱动的结构性高景气。2025Q3 中，消费电子终端应用晶圆收入同比增长 12.71%、环比增长 14.86%，工业与汽车终端应用晶圆收入更是连续两个季度高增，2025Q3 同比大增 66.65%、环比增长 21.81%，对应的正是本土模拟、电源管理、MCU/MPU、车规芯片等需求的集中释放。另外，在消费电子客户由中低端向中高端渗透、产品价值量抬升的带动下，中芯国际凭借 12 英寸占比提升、ASP 上行和 95% 以上的高产能利用率，正在成为国内消费电子与汽车电子国产替代的关键承接平台。相关公司：中芯国际、兆易创新、纳芯微、汇顶科技等

● 风险提示：1、半导体周期风险：半导体行业属于重资产行业，行业扩产资本投入较大，设备折旧、产能利用率波动导致公司利润承压；2、下游需求不及预期：智能手机、消费电子等领域需求增长不及预期；3、国产替代进度不及预期：存量市场竞争下，国内厂商市场份额是核心增长点，国产替代进度或不及预期

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

目录

一、核心观点	3
二、行业跟踪	6
三、行业新闻	9
四、公司公告	15
五、下周重要事件提示	22

图表目录

图 1：消费电子晶圆收入环比提升，智能手机占比下降	3
图 2：工业与汽车终端应用晶圆收入连续两个季度同比高增	4
图 3：中芯国际产能利用率提升至 95.8%，月产能提升至 102.28 万片，首次突破百万	4
图 4：本周各行业版块涨跌幅	6
图 5：本周电子版块：子版块涨跌幅	7
图 6：电子板块历史走势	8
图 7：电子板块历史市盈率	8
 表 1：本周电子板块个股涨幅前五名	6
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名	6
表 3：下周重要会议	22
表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）	24

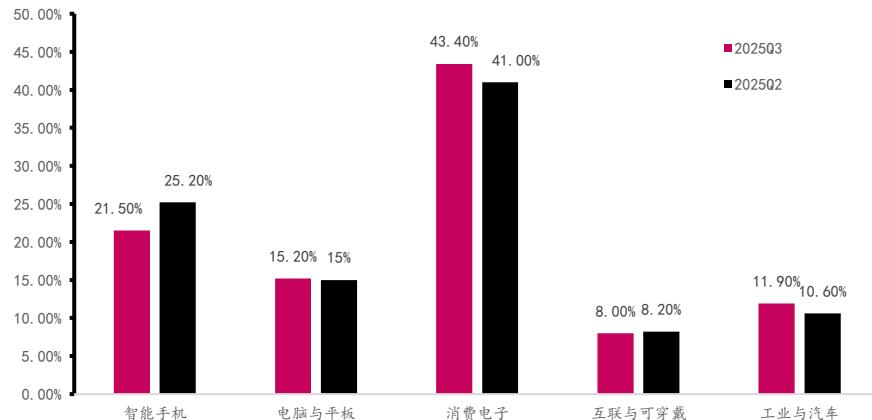
一、核心观点

中芯国际发布2025Q3业绩报告，2025年Q3，中芯国际实现营业收入171.62亿元人民币，同比增长9.9%，环比增长6.9%，单季度收入创历史新高。归属于上市公司股东的净利润为15.17亿元，同比增长43.1%，环比增幅达到60.64%，毛利率提升带来显著增长。公司毛利率超指引，也优于市场预期。

2025Q3，公司整体毛利率为25.5%，环比提升4.8个百分点。产能利用率提升及出货产品结构优化抵消设备折旧压力。

产品结构方面，消费电子国产替代及渗透率提升，出货量占比提升。从终端应用结构上来看，三季度中芯国际晶圆收入中，消费电子占比由41.0%提升至43.4%，较上季度提升2.4个百分点，智能手机晶圆收入占比环比下降3.7个百分点至21.5%；电脑与平板占比小幅上升至15.2%；此外，此前库存压力下，工业与汽车客户偏谨慎，而在2025Q3集中释放，工业与汽车终端应用收入占比由10.6%提升至Q3的11.9%。业绩说明会中，公司管理层指出中芯国际客户此前在消费电子领域处于中低端市场，随着客户产品质量、定位要求不断提升，客户渗透至中高端领域，价值量得以提升，带动公司毛利率改善。

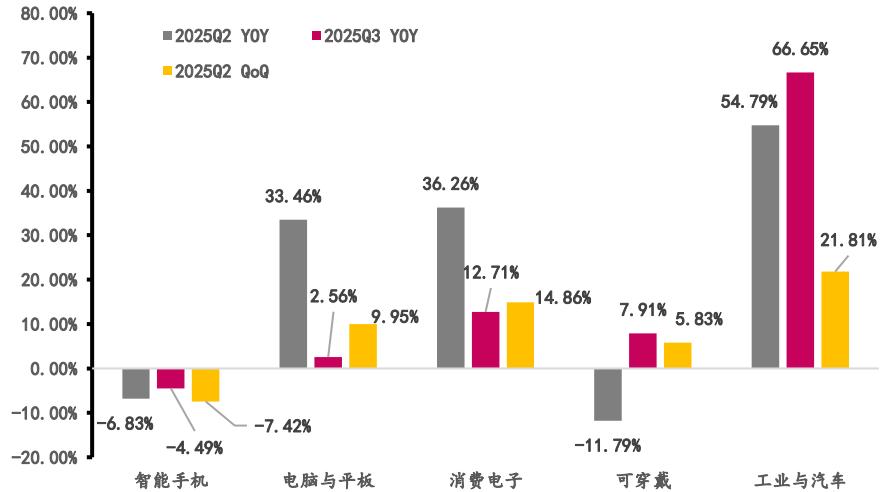
图1：消费电子晶圆收入环比提升，智能手机占比下降



数据来源：中芯国际，金元证券研究所

基于公司晶圆收入占比及各项终端应用占比测算，除智能手机外，其他终端应用晶圆收入均实现同比、环比增长。其中，工业与汽车终端应用晶圆收入连续两个季度同比高增，2025Q3同比增长66.65%，环比增21.81%。消费电子方面，2025Q3同比增长12.71%，环比增14.86%。智能手机连续两个季度同比负增，环比-7.42%。

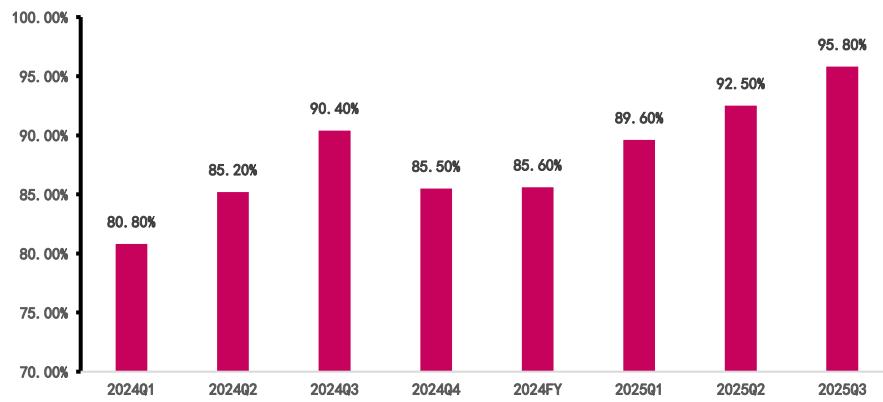
图2：工业与汽车终端应用晶圆收入连续两个季度同比高增



数据来源：中芯国际，金元证券研究所

产能方面，此前生产波动影响消退，公司加速扩产，产能利用率提升冲抵设备折旧压力。2025Q3，中芯国际折算8英寸标准逻辑的月产能已提升至约102.28万片，首次突破百万片。同期晶圆出货量为约249.95万片（折8英寸标准），使得整体产能利用率攀升至95.8%，相比一季度的90.4%、二季度的92.5%持续走高，已接近“满负荷”状态。按晶圆尺寸划分，三季度12英寸晶圆收入占比达77.0%，较二季度进一步提升；8英寸晶圆占比为23%。公司此前曾表示，将逐步取消部分12英寸产品的折扣，从财报和说明会的表述看，这项策略叠加先进制程产品占比提升，对提升ASP（平均售价）与毛利率起到了明显作用。

图3：中芯国际产能利用率提升至95.8%，月产能提升至102.28万片，首次突破百万



数据来源：中芯国际，金元证券研究所

淡季或仍然景气，公司四季度或仍处于供不应求的高产能利用率状态。公司管理层表示，虽然四季度是传统意义上的淡季，但产业链切换、迭代效应仍在持续。

产业链切换与国产化仍在加速，国内客户为了适配国产算力、车规芯片等需求，持续补库存、备货。尽管进入季节性淡季，部分客户备货节奏放缓，但整体订单仍然偏紧，公司产线在四季度仍处于“供不应求、整体满载”状态。此外，针对近期存储涨价问题，公司领导层在业绩说明会上表示，当前存储芯片产能供应偏紧，价格持续飙升，这反过来使得智能手机厂商在整体物料成本压力之下，对代工部分的拿货变得更加谨慎，这也侧面印证了智能手机客户当前的占比略降的原因。对于当前存储市场价格，公司认为市场供需关系仍然紧俏。

中芯国际预计 2025 年全年销售收入将首次突破 90 亿美元，今年资本开支将与去年大致相当或略有增加，以匹配中长期的扩产与技术升级规划。展望四季度，管理层坦言按季节规律本应是传统淡季、客户备货有所放缓，但在产业链迭代与本土化进程推动下，“淡季不淡”的特征明显，公司产线整体仍将保持满载运行，并给出四季度收入环比持平至增长 2%、毛利率 18% - 20% 的指引。

我们认为，中芯国际 2025Q3 业绩报告释放国内消费电子为代表的模拟 IC、MPU 等成熟制程芯片国产替代放量，叠加汽车电子补库存驱动的结构性高景气。2025Q3 中，消费电子终端应用晶圆收入同比增长 12.71%、环比增长 14.86%，工业与汽车终端应用晶圆收入更是连续两个季度高增，2025Q3 同比大增 66.65%、环比增长 21.81%，对应的正是本土模拟、电源管理、MCU/MPU、车规芯片等需求的集中释放。另外，在消费电子客户由中低端向中高端渗透、产品价值量抬升的带动下，中芯国际凭借 12 英寸占比提升、ASP 上行和 95% 以上的高产能利用率，正在成为国内消费电子与汽车电子国产替代的关键承接平台。

相关公司：中芯国际、兆易创新、纳芯微、汇顶科技等

风险提示：

1、半导体周期风险：

半导体行业属于重资产行业，行业扩产资本投入较大，设备折旧、产能利用率波动导致公司利润承压

2、下游需求不及预期：

智能手机、消费电子等领域需求增长不及预期

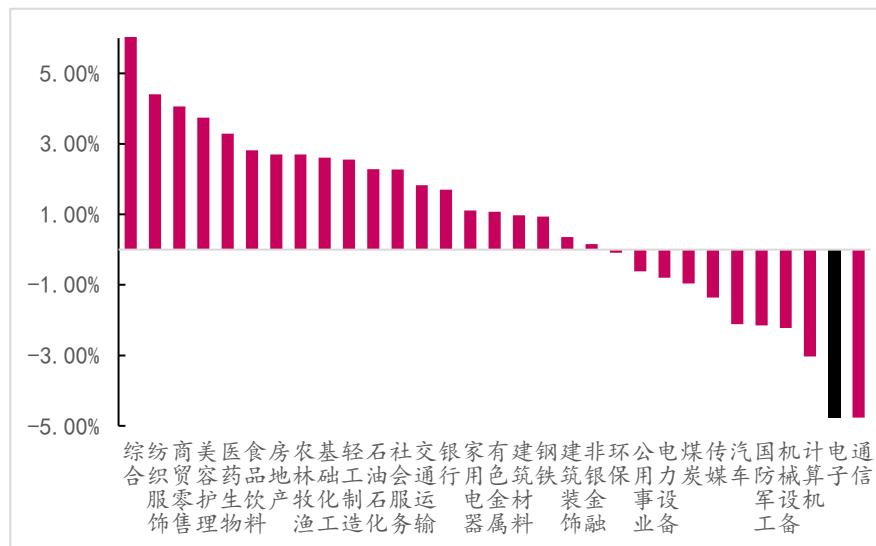
3、国产替代进度不及预期：

存量市场竞争下，国内厂商市场份额是核心增长点，国产替代进度或不及预期

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.11.10–2025.11.14）上证指数下跌 0.18%，深证成指下跌 1.40%，沪深 300 指数下跌 1.08%，申万电子版块下降 4.77%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 30/31。板块个股涨幅前五名分别为：神工股份、百邦科技、胜利精密、联动科技、奥尼科技；跌幅前五名分别为：京泉华、天承科技、康强电子、统联精密、三环集团。

图 4：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价 (元)	周最低价 (元)	周最高价 (元)	周换手率	周成交量 (万手)	周成交金额 (亿元)
688233.SH	神工股份	38.03	70.38	59.00	84.66	62.56	106.55	76.55
300736.SZ	百邦科技	20.89	19.27	15.94	19.71	65.63	82.09	14.78
002426.SZ	胜利精密	19.24	3.78	3.18	4.01	68.60	2334.26	85.41
301369.SZ	联动科技	16.45	104.43	86.21	106.48	36.56	13.29	12.92
301189.SZ	奥尼电子	15.45	38.48	32.45	41.44	24.62	27.52	10.43

数据来源：Choice，金元证券研究所

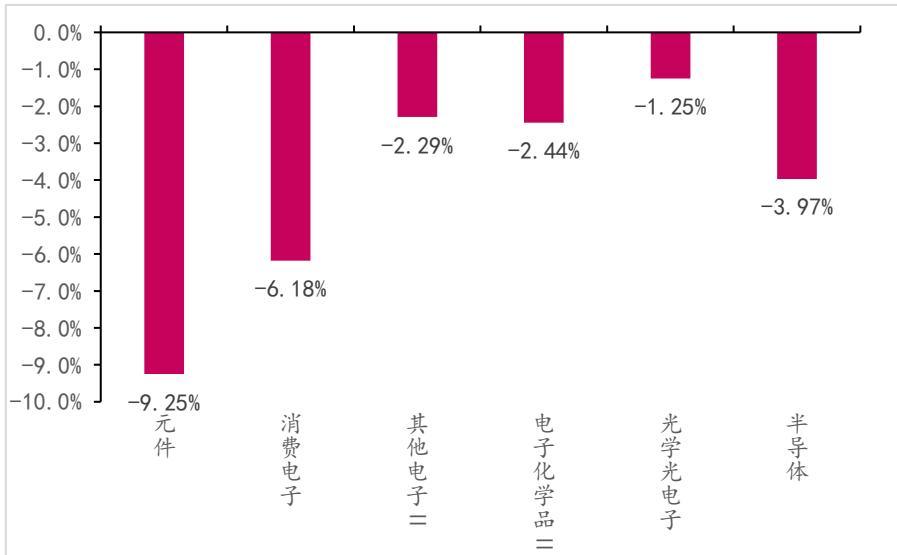
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价 (元)	周最低价 (元)	周最高价 (元)	周换手率	周成交量 (万手)	周成交金额 (亿元)
002885.SZ	京泉华	-21.58	28.20	27.93	36.38	122.65	283.22	89.82
688603.SH	天承科技	-18.42	71.00	71.00	85.97	25.79	12.23	9.44
002119.SZ	康强电子	-15.51	17.81	17.80	21.08	74.87	280.97	55.19
688210.SH	统联精密	-14.80	51.70	48.77	61.60	19.97	32.23	17.22
300408.SZ	三环集团	-14.63	44.45	44.36	53.30	7.60	142.06	68.04

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025.11.10 - 2025.11.14）电子行业整体呈现震荡分化的格局，板块表现冷热不均。从申万二级行业数据来看，各板块涨跌互现。其中，其他电子Ⅱ板块本周下跌 -2.29%，但在多数板块普跌的背景下相对抗跌；其下申万三级行业中 其他电子Ⅲ 同样下跌 -2.29%，走势基本一致。元件板块下跌 -9.25%，为本周表现最弱的方向，细分来看，印制电路板下跌 -1.97%，被动元件大幅下跌 -7.92%，分化明显。半导体板块整体下跌 -3.97%，但内部结构差异较大，其中半导体设备子板块跌幅仅 -0.43%，表现相对突出，分立器件下跌 -4.17%，而模拟芯片设计与集成电路封测分别下跌 -2.26% 与 -4.97%，半导体材料下跌 -1.56%，整体受结构性拖累。光学光电子板块微跌 -1.25%，其中 LED 下跌 -1.94%，光学元件下跌 -4.46%，但面板逆势上涨 +0.69%，板块整体仍显弱势但内部表现分化。消费电子板块下跌 -6.18%，延续调整态势，其中品牌消费电子下跌 -3.26%，消费电子零部件及组装下跌 -4.64%，对板块形成主要拖累。电子化学品Ⅱ板块下跌 -2.44%，电子化学品Ⅲ 子板块同幅下跌 -2.44%，材料端表现平淡。总体来看，本周电子行业涨跌分化明显，面板等个别方向表现较为亮眼，但元件、消费电子与部分半导体细分领域仍承压，行业整体呈现结构性调整态势。

图5：本周电子版块：子版块涨跌幅



申万二级行业	周涨跌幅	申万三级行业	周涨跌幅
半导体	-3.97	分立器件	-4.17
		半导体材料	-1.56
		数字芯片设计	-4.82
		模拟芯片设计	-2.26
		集成电路封测	-4.97
		半导体设备	-3.05
元件	-9.25	印制电路板	-9.15
		被动元件	-9.72
光学光电子	-1.25	面板	0.69

		LED	-1.94
		光学元件	-4.46
消费电子	-6.18	品牌消费电子	-3.26
		消费电子零部件及组装	-6.44
电子化学品	-2.44	电子化学品Ⅲ	-2.44
其他电子	-2.29	其他电子Ⅲ	-2.29

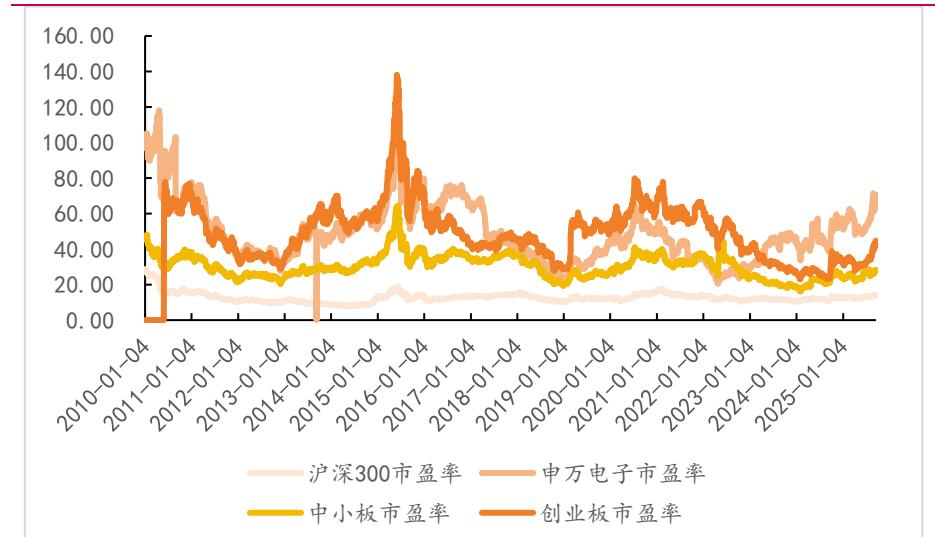
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 6: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 7: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

AMD 加速推进 2 奈米 Venice 与 MI400，性能大幅跃升锁定 2026 上市

11月10日据《科技新报》报道，AMD在2025年第三季财报说明会上，由执行长苏姿丰博士证实采用台积电2奈米制程的 EPYC Venice Zen 6 资料中心处理器与 Instinct MI400系列 AI 加速晶片均按进度推进，预计2026年如期发布。苏姿丰指出，Venice 已进入实验室阶段，性能、效率与运算密度较 Zen 5 的Turin世代大幅跃升，客户参与度与采购意愿创下历史新高，多家云端 OEM 已上线测试以确保未来量产部署顺畅。MI400系列定位承载最苛刻的训练与推理负载，峰值运算达40 PFLOPs，搭载 432GB HBM4 与 19.6TB/s 频宽，并结合新一代计算引擎与高容量堆叠记忆体，直接对标辉达 Rubin。Oracle 已宣布将成为 MI450 的首批大型合作伙伴，OpenAI 亦将采购总计 6GW Instinct GPU，其中包含 1GW MI450，美国能源部则采用 MI430X 搭配 Venice CPU 部署下一代 Discovery 超级电脑。消费端方面，Ryzen 9000 持续推升游戏部门营收年增 181% 至 13 亿美元，FSR 4 技术采纳迅速，支援游戏已突破 85 款。业界认为，AMD 依托 2 奈米制程与 MI400 产品布局，在下一阶段 AI 与资料中心竞争中强化了技术壁垒。

三星德州泰勒市工厂加速兴建，ASML 组团队协助安装 EUV

11月10日据《科技新报》报道，三星与特斯拉签署约 165 亿美元合作协议后，暂停多时的德州泰勒市晶圆厂建设全面加速，以满足特斯拉下一代 AI 6 晶片的产能需求。荷兰曝光机大厂 ASML 已组建团队协助三星进行EUV设备安装，并持续扩大工程人员招募，显示泰勒市工厂已逐渐逼近生产准备阶段。尽管三星加快工程节奏，特斯拉对 AI5 晶片的量产时程则稍显保守。马斯克近期表示，AI5 的样品将在 2025 年释出，少量出货随后启动，但大规模量产需延至 2027 年。下一代性能提升两倍的 AI6 晶片将沿用同一产线，目标在 2028 年中旬量产。业内指出，尽管特斯拉规划出现延后，但三星仍坚持提前安装设备与提升厂务准备，以抢占未来高端 AI 制程产能布局。

德州仪器马六甲 TIEM2 新厂启用，大幅扩张全球封测产能布局

11月10日据《科技新报》报道，德州仪器宣布位于马来西亚麻六甲的第二座封装与测试工厂 TIEM2 已正式投入使用，未来每年将封测数十亿颗类比与嵌入式晶片，强化供应链稳定度。新厂采用先进自动化设备处理凸块、电性探针、组装与测试等后段制程，面积超过 90 万平方英尺，并与既有工厂整合形成逾 140 万平方英尺制造园区。德州仪器累计当地投资逼近 12 亿美元，并创造 500 个工作机会，目标在 2030 年前满足内部九成以上封测需求，进一步掌控供应链关键环节。

ADI 推出全新 CodeFusion Studio 2.0，全面提升嵌入式 AI 系统开发效率

11月10日据《科技新报》报道，Analog Devices 发布 CodeFusion Studio 2.0，为其开源嵌入式开发平台进行重大升级，以简化 AI 系统建置并缩短产品上市周期。新版工具基于 Visual Studio Code，整合系统规划、性能剖析、模型检查、自动化工具链与硬体抽象层，可支援从低功耗 MCU 到高性

能讯号处理器的广泛开发需求。平台提供逐层性能分析、核心转储解析与 GB 除错，并采用 Zephyr 架构强化 AI 工作负载监控。ADI 表示，新版本是推动实体智慧战略的重要里程碑，将进一步降低嵌入式 AI 的开发门槛。

苹果质疑欧盟监管标准矛盾，开放与安全要求出现重大冲突

11 月 10 日据《科技新报》报道，苹果近日致函欧盟监管机构，指出欧盟在数位服务法与数位市场法之间存在监管矛盾：一方面要求强化隐私保护与未成年防护，另一方面却要求开放第三方应用市场并移除既有安全限制，使使用者暴露于更高诈骗与隐私风险。苹果强调已投入大量人力遵循法规，但过度激进的开放要求削弱其保护使用者的能力。苹果在公开信中亦质疑监管机构的调查时机与动机。欧盟方面目前尚未回应，产业认为此争议将成为未来平台治理的关键战场。

AI 需求挤压储存链，HDD 交期暴涨 QLC SSD 急速取代应市

11 月 11 日据《科技新报》报道，随着全球 AI 基础设施扩建速度远超供应链承载能力，企业级储存市场出现罕见缺口。企业级硬碟交期已被迫延长至两年，不少北美与中国云端业者为确保资料中心营运，正大规模改用 QLC NAND 固态硬碟作为替代。QLC 具备更高密度与成本优势，适合冷资料与次级备援储存，但抢购潮随之引发 NAND 市场新一波紧缺，主要 NAND 厂产能几乎已被预订至 2026 年，第四季 SSD 报价恐进一步走扬。AI 推论数据量激增，近线硬碟供不应求，促使高容量 SSD 需求大幅攀升，其中以 QLC SSD 成长最为显著，台厂群联、威刚、创见、宇瞻等有望率先受惠。法人指出，随着 PCIe 5.0 控制器、快取演算法与 QLC 制程成熟，2026 年将成为 NAND 产业迈向结构性平衡的关键节点，储存供应链将迎来新一轮成长周期。

AI 高电流与高速传输需求爆发，贝尔威勒将以 105 元登录兴柜

11 月 11 日据《科技新报》报道，电子连接器厂贝尔威勒将于 11 月 12 日以每股参考价 105 元登录兴柜，公司在法说会上表示，AI 伺服器对高频高速与大电流稳定传输的需求快速攀升，带动高阶连接器采用比重大幅提升。公司以电子连接器、线束、Pogo Pin、FPCA 电路板、金属射出成型为核心业务，成功切入国际 AI 伺服器供应链，2024 年营收成长至 23.01 亿元，毛利率提升至 45%，税后净利 3.22 亿元，每股纯益 5.86 元。贝尔威勒以台湾为研发基地，中国昆山为主要量产中心，越南兴安厂预计 2025 年投产，并将在欧美亚设立区域 HUB 强化即时供应。公司客户包含 Acer、亚马逊、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、Nvidia 等国际大厂，并与仁宝、富士康、英业达、广达、纬创、纬颖等合作超过 1100 家品牌。公司长期参与 OCP、USB-IF、PCI-SIG、JEDEC、UALink 等国际标准组织，以强化技术导入全球规格体系的能力。贝尔威勒正积极开发高电流、高频高速与防水连接器，应用扩及储能、车电、医疗与工业控制，预期将持续扩大市占。

宜特启动次 2 奈米 ALD 新材料平台，切入材料端验证关键链路

11 月 11 日据《科技新报》报道，半导体验证厂商宜特宣布正式启动次 2 奈米世代原子层沉积新材料的选材与验证服务，使业务从晶片验证延伸至化学材料端的配方筛选、镀膜实验与品质确认，成为材料开发加速器。宜特指

出，晶圆代工大厂与 IDM 将于 2025 年下半年陆续在 2 奈米与 18A 进入量产，皆采用立体电晶体架构，使 ALD 在 3D 结构中的均匀镀膜需求大幅提升。CVD 与 PVD 在深层覆盖上受限，而 ALD 可透过原子层沉积实现高均匀度与完全覆盖，是 2 奈米后制程关键技术，但其沉积速度慢、参数窗口窄，新材料反应条件需高度掌握。宜特的新平台整合材料选择、镀膜制程、薄膜分析与制程验证，可显著缩短材料商开发周期，加速材料端与晶片端的串接。公司认为，未来半导体突破更仰赖新材料导入，其 ALD 平台将成为推动次 2 奈米世代的重要力量。宜特公布 10 月合并营收 3.93 亿元，年增 8.64%，累计前十月 40.05 亿元，年增 11.22%，创同期新高。

技嘉推出 RTX PRO 6000 伺服器，整合全套 NVIDIA 运算与网路架构

11 月 11 日据《科技新报》报道，技嘉集团旗下技嘉科技推出全新 GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 伺服器，采用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU、BlueField-3 DPU、ConnectX-8 SuperNIC，并整合 NVIDIA AI Enterprise 平台，实现从高效运算、网路到模型部署的全流程加速架构。系统最多支援八张 RTX PRO 6000 GPU，总计 768GB GDDR7 记忆体，适用于生成式 AI、3D 渲染、科学模拟等高密度任务，搭载双 Intel Xeon 6700 或 6500 系列处理器、32 组 DDR5，并采用 3+1 冗余 3200W 电源确保稳定高效。BlueField-3 DPU 提供每秒 400Gb 频宽，ConnectX-8 SuperNIC 让八张 GPU 获得每张每秒 800Gb 高速互联，支持分散式训练架构。系统可搭配 NVIDIA NIM、Omniverse、Cosmos，并支援 Windows、Linux、Kubernetes 与虚拟化环境，适用于机器人模拟、预测建模、医疗研究与 3D 内容生产，为企业构建下一代 AI 工厂提供强力基础。

英特尔技术长转投 OpenAI，陈立武亲自接掌 AI 事业布局

11 月 12 日据《科技新报》报道，英特尔确认执行长陈立武将亲自领导 AI 与先进技术团队，原因是原技术长兼 AI 主管卡蒂于日前宣布加入 OpenAI。卡蒂在今年 1 月管理层重组后负责英特尔 AI 业务，如今在社群平台 X 宣布将协助 OpenAI 设计与建置运算基础设施，推动通用人工智能研究扩展。英特尔表示感谢其贡献，并强调陈立武上任后将持续强化 AI 战略，推动技术蓝图并满足新兴应用需求。自陈立武 3 月接任执行长以来，英特尔已有多位高阶主管离职，晶圆代工业务因缺乏主要客户面临困境，且暂未推出能与辉达与台积电在 AI 资料中心竞争的关键产品，使 AI 业务成为英特尔下一阶段转型的重中之重。

美光大幅调整扩产计划，纽约厂再度延后优先投入爱达荷布局

11 月 12 日据《科技新报》报道，美光在最新公开文件中确认其位于纽约克雷的晶圆厂建设将再度延后，第一座晶圆厂原本预计 2026 年动工、2028 年启用，最新时程将延到 2030 年底运营；第二座则从 2030 年延至 2033 年底，其余两座工厂也顺延至 2035 年与 2041 年，整体园区将于 2045 年全面建成，较原规划延后五年。市场分析指出，此调整可能与美国商务部 61 亿美元融资协议的执行要求变化有关，美光同时决定将更多晶片法案资源优先配置至爱达荷厂区，加速其本地 DRAM 与 HBM 产能建设。美光已将约 12 亿美元补助金自纽约转至爱达荷，使克雷厂获得的联邦资金从 46 亿美元降

至 34 亿美元。公司强调此调整不会影响其在美国达成 40% DRAM 本地生产目标，而爱达荷新厂将优先发展高阶封装与先进记忆体制程，成为公司在美产能布局的核心。

马斯克证实 A16 采用双代工策略，三星与台积电同步生产

11 月 12 日据《科技新报》报道，马斯克最新表示特斯拉 A16 晶片将延续双代工策略，由三星德州泰勒厂与台积电亚利桑那厂同步生产。马斯克指出，A15 与 A16 将由两间代工厂分别制造略有差异的实体版本，但设计与软体均保持一致，各厂差异仅来自设计转译方式不同。他同时确认 A16 的效能将比 A15 再提升约两倍。马斯克公开表示，A15 的效能将比 A14 高出 40 倍，并预计 A15 在 2026 年量产，A16 于其后一至两年间问世。A17 已进入早期设计阶段，并可能采用不同的代工布局。业内认为，特斯拉持续采用双代工模式，有助分散产能风险，也代表设计端已针对不同晶圆厂差异进行优化，以确保推论环境的一致性。

英特尔晶圆代工 2025 年营收仅 1.2 亿美元，与台积电差距逾千倍

11 月 12 日据《科技新报》报道，根据半导体研究机构 SemiAnalysis 的最新估计，英特尔晶圆代工 2025 年营收约 1.2 亿美元，仅为台积电同期收入的千分之一，显示英特尔在代工事业商业化方面仍面临严峻挑战。陈立武上任后，公司在消费级产品、人工智慧及组织结构均进行改革，但晶圆代工仍未形成规模。尽管市场持续关注 intel 18A 与 14A 制程节点能否吸引外部客户，包括特斯拉、博通与微软都在评估，但实际量产实力仍有待验证。陈立武过去曾表示，若 14A 无法取得关键客户，公司可能放缓或终止后续节点开发，显示先进制程能否成功商用将决定英特尔代工事业未来方向。市场普遍认为，与台积电直接比较虽不完全公平，但也反映技术落后将导致长期竞争力不足，在全球半导体制造竞赛中一旦落后便难以追趕。

骏吉科技 DDR4 产品接获订单，预计明年第一季开始出货

11 月 12 日据《科技新报》报道，骏吉控股宣布旗下骏吉科技完成 DDR4 1G b x8 与 512Mb x16 产品开发，并已收到客户预付款，预计明年第一季开始陆续出货。公司表示该订单象征对其技术实力、稳定交期与产品可靠度的肯定，将与策略客户紧密合作以强化长期成长动能。骏吉原为东南亚最大枪钉制造商，新团队入主后积极推动半导体与本业双轨发展，近期已取得美国重要客户标案，将分批出货至数百个标准货柜规模。公司今年前十月累计营收 9274 万元，年减 46.68%，但下半年营运降幅已有收敛迹象。董事长胡德立指出，骏吉已调整台湾、上海与马来西亚三家子公司结构，并由半导体资深经理陈志德出任三地董座，结合供应链经验与管理团队重组，希望推动公司逐步恢复成长动能。

三星与海力士加速 HBM4E 研发，竞逐次世代高端记忆体市场

11 月 13 日据《IT之家》报道，韩国业界消息指出，三星电子与 SK 海力士正全力推进 HBM4E 的开发目标，计划在明年上半年完成研发验证，以抢占次世代高带宽记忆体市场主导权。随着 AI 训练模型快速扩张，HBM 需求持续飙升，两大厂商均由通用型产品转向高客制化规格，加强与大型云服务商及

GPU 厂商的深度合作。报道称，HBM4 在电力效率、堆叠层数及频宽上已进入激烈竞争，而 HBM4E 预计以更高堆叠高度、更严格的功耗管理与定制化接口为亮点。有分析指出，未来 GPU、AI 伺服器厂会要求更高的专属配套设计，HBM 将全面进入“客制化时代”。产业认为，HBM4E 将成为三星与海力士下一阶段竞争关键，谁最先完成验证并取得系统大厂认证，将直接决定 2026 年至 2028 年的市场占有率。

我国发布 UFCS 快充蓝皮书，揭露废旧手机的庞大电子废弃量

11 月 13 日据《IT之家》报道，融合快充产业协会发布《UFCS 产业发展蓝皮书》，指出中国每年产生 6 至 7 亿部废旧手机，家庭长期闲置多条充电线材，电子废弃问题日益突出。蓝皮书说明，随着 UFCS 融合快充标准逐渐推广，终端充电接口、线材与电源适配器的标准化程度逐步提升，可望减少重复生产与闲置配件数量，降低电子垃圾产生量。报告强调，随着 USB-C 与 UFCS 统一规范的发展，预计未来三至五年智能终端快充生态将进入全面兼容阶段，产业链整合将加速推进。产业人士认为，在政策推动与统一标准的双重作用下，电子消费品生命周期管理、绿色供应链与废弃物流向，将成为厂商下一阶段竞争的重要指标。

HPE 联合诺奖团队成立量子扩展联盟，加速下一代量子超级运算平台

11 月 13 日据《IT之家》报道，HPE 宣布联合多家科研机构及新晋诺贝尔奖得主马丁尼斯团队成立量子扩展联盟，目标是利用既有超级计算生态与半导体制造技术，加速量子超级运算机的开发。联盟将围绕量子位元错误修正、晶片封装结构、新型量子互连与混合超级计算架构展开合作，打造可整合量子运算与传统高性能运算的统一平台。专家指出，随着 AI 推理与科学模拟需求急遽攀升，量子运算将从实验阶段加速迈向实用化，而混合计算将可能成为量子时代的主流技术路线。产业认为 HPE 联手材料学、物理学与半导体制造领域的机构，显示量子电脑已从“学术探索”进入“产业布局”阶段。

微软推进自研 AI 晶片受阻，将借助 OpenAI 技术力量强化研发进程

11 月 13 日据《IT之家》报道，微软执行长纳德拉表示，公司正透过与 OpenAI 的深度合作，获取后者的 AI 晶片研发技术，以弥补自研进度落后的的问题。过去两年微软积极推动内部 AI 运算晶片项目，但在设计、能效与软件生态竞争力方面仍无法与辉达的成熟体系相比。纳德拉指出，借助 OpenAI 的模型训练需求与基础设施经验，将有助微软更快推进 AI ASIC、专用加速器与数据中心架构设计。外界认为，微软自研晶片若无法追上辉达，则未来在云端服务成本、模型训练速度与生态控制力上将持续受限，因此借力 OpenAI 成为最务实策略。

Windows 将转型智能体操作系统，大量用户反对微软策略转向

11 月 13 日据《IT之家》报道，微软宣布未来 Windows 系统将全面转型为“智能体操作系统”，计划将 Copilot 与本地 AI 功能深度整合至系统层级，以打造持续学习、自动响应的智能平台。然而消息公布后，大量用户在社区表达强烈反对，认为微软近年强推广告、强制线上账号、系统监控等行为已造成体验恶化，担心智能体系统将进一步侵害隐私与用户自由。分析指出，微软在

与苹果及 Google 的 AI 竞赛中压力巨大，希望借智能体策略抢占下一代 OS 话语权，但能否获得用户接受仍存在高度不确定性。

铠侠业绩不如预期股价回档，市场仍看好 AI 拉动长期成长趋势

11 月 14 日据《科技新报》报道，日本记忆体大厂铠侠公布 2025 年第二季财报后，因营收与营业利益双双不及预期，加上第三季展望偏弱，导致股价当日收盘下跌 1.62%。财报显示第二季营业利益 870 亿日圆，低于市场预期的 960 亿至 1000 亿日圆，第三季预估营收 5000 至 5500 亿日圆、营业利益 1000 至 1400 亿日圆，同样不及预期。主要拖累来自产品组合转弱，智慧装置需求季节性上升，使获利较低的品项占比跳增至 35%，使整体平均售价出现低个位数季减。但若排除产品结构因素，同类产品 ASP 实际上呈现中个位数成长。尽管短期财测疲弱，但市场认为中长期趋势未变，AI 伺服器更换潮、eSSD 推理需求扩张及近线硬碟短缺使供需紧绷，铠侠第四季起将转向高毛利 SSD 产品，2026 年位元数成长预计将达高双位数，且公司已开始与客户洽谈 2027 年甚至更长期的供货合约。加上未来将专注在 G8 与 G10 BiCs 技术，分析师普遍认为铠侠仍处于长期上涨周期中。

NAND 大厂酝酿以量制价，明年下半年同步减产以推升报价

11 月 14 日据《科技新报》报道，韩国媒体指出三星、SK 海力士、铠侠、美光等全球主要 NAND 制造商正讨论在 2025 年下半年共同缩减供应量，以藉由减产提升 NAND 报价。三星正与大型客户洽谈 2025 年供货，内部讨论将价格上调 20% 至 30% 以上；SK 海力士预计将 NAND 供应量从 2024 年的 201 万片降至明年的 180 万片，美光位于新加坡的主要工厂也维持在每月 30 万片的低水准产能。研究机构指出，NAND 价格上季已上涨 15%，未来涨幅可能扩大至 40% 至 50%。此外主要厂商正将资源自 TLC 转向更具容量优势的 QLC，因 QLC 在相同面积下可提升三成容量，较适合 AI 资料中心的大容量 SSD 应用。TLC 设备在制程转换期间出现部分停机，进一步形成天然减产效应。在供需结构急速收敛下，北美大型科技企业甚至提前进行采购以避免价格飙升，美国某 NAND 供应商自本月起已将合约价格上调最高 50%。

英特尔股价再下挫，OpenAI 明确排除采购英特尔晶片引发关注

11 月 14 日据《科技新报》报道，OpenAI 最新决定未来不考虑采购英特尔晶片，成为英特尔股价再度下跌的关键因素之一。英特尔曾是 PC 与服务器处理器龙头，但在人工智能竞争中快速边缘化，而 OpenAI、微软、亚马逊与甲骨文等企业近年皆未选择英特尔的 AI 运算晶片。2017 年英特尔曾拒绝投资 OpenAI，如今市值跌至约 450 亿美元，远低于辉达的数兆美元规模，反映双方在生态系统与产品能力上的巨大差距。目前 OpenAI 与博通合作开发自家运算晶片、部署逾百亿美元项目，进一步减少对辉达 GPU 的依赖，同时采用多供应商策略提升成本与性能弹性。英特尔近期 CTO 与 AI 主管跳槽至 OpenAI，AI 团队由执行长陈立武直接指挥，但在硬体性能、软体生态与 CUDA 对应能力均处于明显弱势。OpenAI 预计在未来建立 30 吉瓦级计算资源扩张规模，若英特尔无法在短期内提出具竞争力的 AI 芯片，将面临更严峻的市场挑战。

Galaxy S26 晶片采用双路线，高通占七成、三星 2 奈米良率限制导入比例
 11月14日据《科技新报》报道，韩国业界消息指出，2026年的Galaxy S 26系列将以高通Snapdragon 8 Elite Gen 5为主要平台，占比约七成，而三星自研的Exynos 2600因2奈米制程仍处良率爬升阶段，供应量受限，仅占整体三成。S26 Ultra将全面采用Snapdragon，以确保旗舰机稳定度，S26与S26+则视市场区隔采用不同处理器：北美以Snapdragon为主，韩国与部分欧洲市场采用Exynos。Exynos 2600引入HPB导热结构封装以改善长时间AI运算的散热表现，是其通过评估的重要原因。但由于量产规模仍受2奈米制程限制，最终导入市场的范围受到抑制。高通在旗舰占比仍明显领先，短期内市场格局难出现显著变化。三星预计在2025年2月25日于旧金山发表S26系列，因机型调整使整体时程略为延后。

IBM推出Loon实验性量子晶片，朝2029年实用量子电脑迈进

11月14日据《科技新报》报道，IBM宣布成功制造名为Loon的实验性量子运算晶片，成为其在2029年打造实用量子电脑路线图上的重要里程碑。量子电脑可在极短时间解决传统电脑需数千年才能运算的复杂问题，但量子位元极易受干扰产生错误，因此错误修正机制是业界竞争重点。IBM于2021年提出将通讯演算法改编应用于量子计算，并结合传统晶片与量子晶片进行错误修正，但也使量子晶片制造难度大幅提高，因为必须在量子位元之间加入全新的量子连结结构。IBM表示本次突破来自纽约奥尔巴尼奈米科技园区，其先进制程设备让这些结构得以实现。Loon仍处早期阶段，IBM尚未公布对外测试时程，但另一款Nighthawk晶片将在今年底向外部开放。IBM预计明年底前Nighthawk能在部分任务上超越传统电脑，并计划开放相关原始码供学界与企业共同验证。公司表示目标是从研究论文走向真实应用，建立任何人都能提交程式并由社群实测的量子计算生态。

四、公司公告

一博科技：关于股东股份减持计划时间届满暨实施情况的公告

公司于11月11日发布公告，深圳市一博科技股份有限公司披露股东领荟基石股权投资合伙企业(有限合伙)此前披露的股份减持计划已于近日届满。根据公司此前公告，领荟基石自2025年7月21日起的三个月内拟减持不超过公司总股本2.9834%的股份，减持区间为公告披露之日起至15个交易日后的三个月内。公司于11月5日与11月6日的提示性公告中披露，领荟基石在9月25日至11月5日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1,569,380股，减持比例为0.574%，其持股比例降至4.9999%，不再属于公司持股5%以上的股东。公司表示，截至公告披露日，公司已收到领荟基石出具的《关于股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，确认其减持计划期限已届满，后续如领荟基石对持股安排作出变动，公司将根据相关规定及时披露。

蓝特光学：董事减持股份计划公告

公司于11月13日发布公告，浙江蓝特光学股份有限公司披露董事王芳立

先生拟减持其所持公司股份的计划。根据公告，截至公告披露日，王芳立先生持有公司股份 49,561,021 股，占公司总股本的 12.2880%，上述股份来源均为公司首次公开发行前股份且已解除限售并上市流通。根据减持计划，王芳立先生拟自公告发布之日起 15 个交易日后的未来 3 个月内，通过集中竞价与大宗交易方式合计减持不超过 8,066,568 股，占公司总股本比例不超过 2.0000%。其中，通过集中竞价方式减持股份不超过 4,033,284 股，占公司总股本比例不超过 1.0000%；通过大宗交易方式减持股份不超过 8,066,568 股，占公司总股本的比例不超过 2.0000%。王芳立先生所持股份均已于 2023 年 9 月 21 日解除限售并上市流通。公司表示，本次减持安排不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构、持续经营能力及财务状况造成不利影响，实际减持情况将依据市场情形及相关法律法规实施，公司将按照监管要求持续履行行业绩披露义务。

利通电子：实际控制人、董事、高管减持股份计划公告

公司于 11 月 13 日发布公告，江苏利通电子股份有限公司披露实际控制人邵骥华女士及相关董事、高级管理人员拟实施的股份减持计划。公告显示，邵骥华女士目前直接持有公司股份 18,935,980 股，占公司总股本的 27.2253%；实际控制人邵培生先生直接持有公司股份 8,988,560 股，占公司总股本的 12.9527%；高管许立群先生持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.1526%，上述股份均为公司首次公开发行前取得。根据公告，邵骥华女士拟在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份不超过 4,733,900 股；邵培生先生拟减持不超过 2,620,800 股；许立群先生拟减持不超过 75,000 股，三人合计减持比例不超过公司总股本的 2%。公司表示，本次减持计划符合相关法律法规要求，不会对公司治理、经营管理及控制权结构产生不利影响。公司将根据交易所规定及时披露实际减持进展情况。

弘信电子：关于股东、董事减持股份计划的预披露公告

公司于 11 月 11 日发布公告，厦门弘信电子科技股份有限公司披露，公司股东张共女、董事李震先生及陈素贞女士拟分别通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持所持本公司股份。根据公告，上述股东分别持有公司股份 2,951,716 股、280,000 股及 570,000 股，持股比例分别为 0.6117%、0.0580% 及 0.1181%。本次拟减持计划的减持时间区间自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 2 月 28 日（法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外）。其中，张共女女士计划减持数量不超过 2,951,716 股，占公司总股本比例不超过 0.6117%；董事李震先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持数量不超过 70,000 股，占公司总股本比例不超过 0.0145%；陈素贞女士计划减持数量不超过 142,500 股，占公司总股本比例不超过 0.0295%。公司表示，具体减持安排将依据市场情况及股价表现确定，相关事项将按照监管要求履行持续信息披露义务。

绿联科技：持股 5% 以上股东及一致行动人减持股份触及 1% 整数倍的公告

公司于 11 月 11 日发布公告，深圳市绿联科技股份有限公司披露此前大股东深圳市绿联管理咨询合伙企业及一致行动人深圳市和顺四号管理咨询合伙

企业的减持计划已触及 1% 整数倍。根据公告，绿联管理持有公司股份 54,924,033 股，占总股本 13.24%，其与一致行动人计划于公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2025 年 11 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过 6,223,649 股，占公司总股本比例不超过 1.50%。截至 11 月 10 日，公司收到绿联管理及一致行动人出具的通知，其已于 11 月 8 日至 11 月 10 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,351,113 股，占总股本比例 0.33%，累计减持比例由 13.24% 降至 12.91%，触及 1% 整数倍，公司已按规定披露。本次减持属于股东出于自身资金安排开展，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

日久光电：关于控股股东、实际控制人持股比例变动触及 1% 整数倍的公告
 公司于 11 月 11 日发布公告，江苏日久光电股份有限公司披露控股股东、实际控制人陈晓俐女士及其一致行动人在此前披露的减持计划实施期间内，已累计减持公司股份触及 1% 整数倍位置。陈晓俐女士持有公司股份 30,196,407 股，占公司总股本比例 9.3103%，其于计划期间拟通过集中竞价方式减持不超过 10,287,132 股，占公司总股本比例不超过 3%。截至公告披露日，公司收到陈晓俐女士出具的通知，其在 2025 年 1 月 23 日至 11 月 10 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,756,400 股，占公司当前总股本的比例为 0.9807%，累计减持股份达到 1% 整数倍，公司已依规披露。公告指出，上述减持行为符合既定计划安排，不会对公司正常经营及控制权稳定造成影响。公司控股股东及一致行动人合计持股由 74,291,271 股减少至 71,534,871 股，占公司总股本比例由 26.4319% 降至 25.4215%，公司后续将根据减持情况持续披露相关进展。

英飞特：关于减持股份实施进展暨权益变动触及 1% 整数倍的公告

公司于 11 月 10 日发布公告，英飞特电子（杭州）股份有限公司披露控股股东、实际控制人 GUICHAO HUA 先生此前披露的减持计划实施进展情况。根据公司 2025 年 9 月 22 日披露的相关公告，GUICHAO HUA 先生拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 10 月 2 日至 2026 年 1 月 21 日）通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 13,420,570 股，占公司总股本的比例不超过 2.82%。近日公司收到 GUICHAO HUA 先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨权益变动触及 1% 整数倍的告知函》，截至 2025 年 11 月 10 日，GUICHAO HUA 先生因实施减持计划以及公司激励股份权益变动使其持股比例发生变动，累计触及公司股份总数的 1% 整数倍。公司表示，后续若 GUICHAO HUA 先生继续调整持股计划，公司将依规及时披露相关情况。

中科飞测：关于签订募集资金专户存储三方、四方监管协议的公告

公司于 11 月 12 日发布公告，深圳中科飞测科技股份有限公司披露已与相关银行、会计师事务所及控股股东签署募集资金三方及四方监管协议。根据中国证监会于 2025 年 8 月 4 日出具的核准文件，公司于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额不超过 250,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

1,923.26万元，超额募集资金净额为人民币248,076.74万元。公司已依据监管要求在指定银行开立募集资金专用账户，由保荐机构及会计师事务所对募集资金的存储及使用情况实施全过程监督。公告显示，公司董事会于2025年10月15日审议通过《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并签署监管协议的议案》，同意公司及控股股东签署募集资金用途相关的三方与四方监管协议，以保证募集资金专户存储、专款专用，并确保资金使用的合法合规。公司表示，签署上述协议有利于进一步规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范募集资金管理风险，上述协议的签署及实施不会对公司日常经营活动产生不利影响。

长光华芯：股东及董事减持股份结果公告

公司于11月11日发布公告，苏州英甄创业投资合伙企业（有限合伙）持有苏州长光华芯光电技术股份有限公司股份26,130,000股，占公司总股本的14.82%，为公司首次公开发行前取得的股份及公认误股所得，均已解除限售并上市流通。本次减持计划实施前，苏州英甄已披露《股份减持股份计划公告》，计划通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过2,613,000股，占公司总股本比例不超过1.48%。截至11月11日，苏州英甄已通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份2,613,000股，占公司总股本1.48%，本次股份减持计划实施完毕。此外，公司董事田喜凯持有公司股份105,040股，占公司总股本0.0596%，该部分股份为公司首次公开发行前取得的股份及公认误股所得，已解除限售并上市流通。根据此前披露的《董事减持股份计划公告》，田喜凯计划减持数量不超过26,260股，占公司总股本比例不超过0.0149%。截至11月11日，田喜凯已通过集中竞价方式累计减持公司股份26,260股，占公司总股本0.0149%，减持计划实施完毕。

中电港：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告

公司于11月15日发布公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持股5%以上股东，依据此前披露的减持计划，于公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份22,797,002股，占公司总股本的约3%。截至11月13日，国家大基金继续实施减持并触及1%整数倍，累计减持45,591,900股，占公司总股本的约6.06%。公司表示，本次减持符合相关法律法规要求，不会对公司正常经营和股权结构稳定性产生重大不利影响。

风华高科：关于广东广晟财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
 公司于11月10日发布公告，广东风华高新科技股份有限公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，本次协议有效期为3年。在协议有效期间，财务公司将依据公司日常资金需求提供存款、贷款等服务，其中存款最高不超过人民币30亿元，外币存款按国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折算后不超过等值30亿元人民币；贷款最高不超过人民币13亿元。根据披露，财务公司向公司收取的综合授信额度、外币综合授信额度按月结息，贷款年利率为人民银行公布的同期贷款市场报价利率为基础确定。公司于2022年11月24日召开股东大会审议通过前期金融服务协议之续期，公司董事会表示本次签署的协议条款在有效期内合法合规、履行程序完备。财务公司系公司第一

大股东广东省广晟控股集团有限公司控股的子公司，构成关联方，根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，本次交易构成关联交易。公司于11月10日召开的董事会会议审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，独立董事发表明确同意意见，认为协议定价公允、程序合规，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

致尚科技：关于〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的公告

公司于11月12日发布公告，深圳市致尚科技股份有限公司披露与深圳市恒杨数据股份有限公司就先前签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》相关内容进行了修订，双方于2025年8月11日已签署补充协议，对过渡期损益安排等条款进行调整。根据公告披露，标的公司恒杨数据原股东因过渡期内应承担的归属损益将由补偿方式予以弥补，涉及的发行股份数量和支付现金金额将按修订后的方式重新确认。公司表示，本次补充协议的签署是基于交易推进过程中出现的新情况及双方协商结果，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，后续公司将根据审核进展继续履行信息披露义务。

鼎佳精密：2025年第四次临时股东会议决议公告

公司于11月12日发布公告，苏州鼎佳精密科技股份有限公司召开了2025年第四次临时股东大会，会议以现场加网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，会议合法有效。会上审议通过了大会通知所列各项议案，出席会议的股东及股东代理人共5人，合计持有表决权股份约60,000,200股，占公司表决权股份总数的72.2894%；通过网络投票方式出席会议的股东1人，持有表决权股份200股，占公司表决权股份总数的0.0002%。公司表示，本次股东大会的召集程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果真实、有效，公司将按程序办理后续的信息披露及相关事项。

贝仕达克：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司于11月12日发布公告，深圳贝仕达克技术股份有限公司披露公司股东林州市启运企业管理合伙企业（有限合伙）及林州市启运企业管理合伙企业（有限合伙）（普通合伙人深圳市凯新创新电子投资合伙企业（有限合伙））此前披露的减持计划期限已届满。根据此前披露的内容，两名股东自2025年8月13日至2025年11月12日合计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过9,298,731股，占公司总股本比例不超过3.9848%。截至公告披露日，股东启运企业合计减持公司股份8,345,408股，占公司总股本比例2.6788%，副权益产品账户合计减持公司股份3,099,571股，占公司总股本比例0.9942%。公司表示，减持计划已实施完毕，后续将根据相关规定持续履行信息披露义务。

奕东电子：2025年第二次临时股东会议决议公告

公司于11月12日发布公告，奕东电子科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场投票与网络投票相结合方式召开。本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情形，亦不存在涉诉事

项及更改会议地点的情况。会议现场于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 举行，网络投票时间为 2025 年 11 月 12 日当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，网络投票系统按深圳证券交易所规定执行。会议地点为广东省东莞市塘厦区向城图文科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室，会议由董事长项玉泉主持，会议的召集及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容合法有效，公司将依规办理后续信息披露事项。

和而泰：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告

公司于 11 月 12 日发布公告，深圳和而泰智能控制股份有限公司披露本次回购注销部分已授予但尚未解除限制的限制性股票方案已获董事会及监事会审议通过。根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，公司拟对已离职激励对象所持有的共计 94.32 万股限制性股票以 5.60 元/股的价格予以回购注销。本次注销完成后，公司注册资本由 924,694,285 元减少至 924,638,285 元，减少注册资本金额 56 万元。依照《公司法》规定，公司已启动债权人通知及公告程序，债权人自公告之日起 45 日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保，若债权人未在规定期限内主张权利，公司将依法继续办理减少注册资本相关手续。

鼎佳精密：2025年第三季度权益分派实施公告

公司于11月12日发布公告，苏州鼎佳精密科技股份有限公司披露2025年第三季度权益分派方案已获股东大会审议通过，本次权益分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。公司表示，本次权益分派在自有申报表方式配列利润为287,484,746.36元的基础上，母公司未分配利润为117,027,349.95元。本次权益分派计划派发现金红利49,800,000.00元。具体方案为：以公司现有总股本830,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司提示，本次权益分派中个人股东、证券投资基金适用股息红利用途差别化个人所得税政策，持股超过1个月但不足1年者每10股需缴纳0.60元税款；持股超过1年者免税；对合格境外机构投资者代理扣缴10%税率后实际每10股派发0.54元。公司提醒投资者注意本次权益分派的税务处理方式及到账时间安排。

海能实业：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

公司于11月13日发布公告，安福盈辉商业控股有限公司持有公司18,921,600股股份，占公司总股本的6.04%，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月5日至2026年3月4日），通过大宗交易和集中竞价方式合计减持不超过940.29万股，减持比例不超过公司总股本的3%。公司近日收到周洪军先生出具的《股份减持计划告知函》，周洪军先生持有公司13.43万股股份，占公司总股本的0.04%，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过13.43万股，减持比例不超过0.04%。若以集中竞价和大宗交易合计方式测算，本次整体拟减持股份数量不超过626.86万股，占公司总股本的2%。公司将根据后续进展情况依法履行信息披露义务。

康强电子：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

公司于 11 月 14 日发布公告，宁波康强电子股份有限公司披露持股 5% 以

上股东司麦司电子科技有限责任公司拟减持股份事项。根据公司公告，司麦司电子截至公告披露日持有公司股份 24,469,906 股，占公司总股本比例 6.52%，其自身资金需求为由，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,752,600 股，占公司总股本比例不超过 1%。公司表示，本次减持计划尚未实施，减持期间及方式将依规执行，若后续进展触及相关披露要求，公司将及时披露后续进展情况。

帝奥微：关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

公司于 11 月 15 日发布公告，江苏帝奥微电子股份有限公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司此前于 2024 年 8 月 16 日审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并披露了激励对象及拟授予的股票数量等相关内容。随后因公司股票在业绩考核期内发生权益分派事项，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整后的授予价格综合考虑公司在报告期内的利润分配情况、资本公积转增因素及其他权益变动影响，经测算，公司限制性股票授予价格由原标准调整为 18.96 元/股。公司表示，授予价格的调整符合激励计划相关规定，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

中芯国际：2025 年第三季度营收同比增长，先进工艺推动业绩改善

中芯国际发布 2025 年第三季度报告，公司本季营收保持增长态势，毛利率与净利润较上一季度均实现改善。公司表示，随着成熟制程需求企稳及部分先进工艺产能利用率提升，本季度整体经营表现优于预期。公告中指出，公司管理层已确认财务数据真实、准确、完整，且不存在虚假记载或重大遗漏。本季度公司主要风险来自全球经济波动、市场需求不确定性、供应链变化等因素，但总体经营状况保持稳健。中芯国际强调，未来将持续加大技术研发投入，推进重点产线扩产，以提升工艺良率与交付能力，力争在全球半导体市场竞争中巩固领先地位。

华虹半导体：2025 年第三季度运营表现保持稳健

华虹半导体发布 2025 年第三季度报告，公司本季收入约 6.352 亿美元，符合指引预期；毛利率达到 13.5%，处于公司年度预期区间内。公司表示，在全球半导体需求回暖背景下，主营业务订单保持稳定，旗下 200mm、300mm 生产线均维持较高稼动率。公司持续推动工艺改进、产品组合升级及成本优化，使盈利能力进一步改善。管理层强调，尽管外部市场存在波动，但公司在电源管理、功率器件、MCU 等核心业务板块仍保持稳固市场地位，并将持续推动车规产品、工控产品及特色工艺平台的扩张，以支持长线增长策略。

五、下周重要事件提示

表3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第三届 中国电气工程大会	11.20-11.23	杭州市	中国电工技术学会等联合主办
2	2025 IEEE 第六届计算机、大数据与人工智能国际会议	11.21-11.23	厦门市	IEEE 中国联合会、华侨大学等
3	2025 第32届中国国际电力设备与技术展览会 & 第25届上海国际电气设备展览会	11.18-11.20	上海市	中国电力企业联合会、国家电网有限公司等

公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	盈方微	股东大会举办	2025-11-21	
2	华天科技	股东大会举办	2025-11-21	
3	鼎龙股份	股东大会举办	2025-11-21	
4	硕贝德	股东大会举办	2025-11-21	
5	四会富仕	股东大会举办	2025-11-21	
6	格林精密	股东大会举办	2025-11-21	
7	福蓉科技	股东大会举办	2025-11-21	
8	华润微	股东大会举办	2025-11-21	
9	鸿富瀚	股东大会举办	2025-11-20	
10	泰晶科技	股东大会举办	2025-11-20	
11	兆易创新	股东大会举办	2025-11-20	
12	新相微	股东大会举办	2025-11-20	
13	纬达光电	股东大会举办	2025-11-20	
14	大港股份	股东大会举办	2025-11-19	
15	上海新阳	股东大会举办	2025-11-19	
16	久之洋	股东大会举办	2025-11-19	
17	广信材料	股东大会举办	2025-11-19	
18	弘信电子	股东大会举办	2025-11-19	
19	云汉芯城	股东大会举办	2025-11-19	
20	拓荆科技	股东大会举办	2025-11-19	
21	杰华特	股东大会举办	2025-11-19	
22	恒玄科技	股东大会举办	2025-11-19	
23	好上好	股东大会举办	2025-11-18	
24	沃尔核材	股东大会举办	2025-11-18	
25	维信诺	股东大会举办	2025-11-18	
26	ST 新亚	股东大会举办	2025-11-18	
27	金安国纪	股东大会举办	2025-11-18	
28	好利科技	股东大会举办	2025-11-18	

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

29	京泉华	股东大会举办	2025-11-18
30	中石科技	股东大会举办	2025-11-18
31	南极光	股东大会举办	2025-11-18
32	波长光电	股东大会举办	2025-11-18
33	至纯科技	股东大会举办	2025-11-18
34	至正股份	股东大会举办	2025-11-18
35	钜泉科技	股东大会举办	2025-11-18
36	富创精密	股东大会举办	2025-11-18
37	成都华微	股东大会举办	2025-11-18
38	TCL 科技	股东大会举办	2025-11-17
39	京东方A	股东大会举办	2025-11-17
40	雅克科技	股东大会举办	2025-11-17
41	兴森科技	股东大会举办	2025-11-17
42	沪电股份	股东大会举办	2025-11-17
43	万润科技	股东大会举办	2025-11-17
44	宝明科技	股东大会举办	2025-11-17
45	扬杰科技	股东大会举办	2025-11-17
46	激智科技	股东大会举办	2025-11-17
47	飞荣达	股东大会举办	2025-11-17
48	旭光电子	股东大会举办	2025-11-17
49	凯盛科技	股东大会举办	2025-11-17
50	可川科技	股东大会举办	2025-11-17
51	易德龙	股东大会举办	2025-11-17
52	沃格光电	股东大会举办	2025-11-17
53	睿能科技	股东大会举办	2025-11-17
54	澳弘电子	股东大会举办	2025-11-17
55	纳芯微	股东大会举办	2025-11-17
56	汇成股份	股东大会举办	2025-11-17
57	裕太微	股东大会举办	2025-11-17
58	瑞联新材	股东大会举办	2025-11-17
59	天承科技	股东大会举办	2025-11-17
60	艾为电子	股东大会举办	2025-11-17
61	瑞可达	股东大会举办	2025-11-17
62	华岭股份	股东大会举办	2025-11-17

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解售股份类型
					流通A股	占比(%)	流通A股	占比(%)	
2025-11-									
688653.SH	康希通信	17	318.40	42,448.00	31,051.44	73.15	31,369.84	73.90	首发战略配售股份
688362.SH	甬矽电子	2025-11-17	12,983.50	41,048.30	28,064.80	68.37	41,048.30	100.00	首发原股东限售股份
2025-11-									
300976.SZ	达瑞电子	18	12.81	13,410.42	8,617.73	64.26	8,617.73	64.26	股权激励限售股份
300671.SZ	富满微	2025-11-18	116.32	21,772.45	21,715.15	99.74	21,831.47	100.27	股权激励一般股份
2025-11-									
688079.SH	美迪凯	18	352.75	40,859.12	39,791.90	97.39	40,144.65	98.25	股权激励限售股份
920179.BJ	凯德石英	2025-11-18	5.00	7,497.00	5,966.85	79.59	5,971.85	79.66	追加承诺限售股份上市流通
2025-11-									
688582.SH	芯动联科	18	102.34	40,071.57	24,919.57	62.19	25,021.91	62.44	股权激励一般股份
920060.BJ	万源通	2025-11-19	8,194.34	15,204.47	7,010.13	46.11	15,204.47	100.00	公开发行原股东限售股份
2025-11-									
002213.SZ	大为股份	21	5.34	23,744.29	20,669.33	87.05	20,674.67	87.07	股权激励限售股份

数据来源：Choice，金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15% 以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 -5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 -5%~+15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。